

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于增加向金融机构申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月8日召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过《关于增加公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

#### 一、2024年已审批综合授信额度情况

公司于2024年3月28日、2024年4月29日分别召开第五届董事会2024年第二次会议、2023年年度股东大会，审议通过《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》，为满足公司及子公司生产经营和投资建设的资金需要，公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度总额为不超过6亿元人民币（含），授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮资讯网披露的《关于公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-019）。

#### 二、本次拟增加综合授信额度的情况

公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，在原审议通过的授信额度基础上公司及子公司增加2024年度综合授信额度6亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。本次增加授信额度后，公司及子公司可向金融机构申请综合授信额度为不超过人民币12亿元人民币（含）。

公司及子公司取得一定的金融机构综合授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司及子公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。目前，公司及子公司生产经营正常，财务状况良好，具有足够的偿债能力。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日